


承認書 SPECIFICATION FOR APPROVAL



\ 型號&料號 產品名稱&概述 \	碩方型號 SOFNG PART NO.	客戶料號 CUSTOMER PART NO.	產品分類 SPECIFICATION
	SMO-1512		MICRO SIM 卡座/SMT 物料/PUSH-PUSH
產品尺寸	L-16.3mm × W-14.6mm × H-1.8mm		
產品特性	高壽命負荷 8.0K 次、錫基鍍金(鹽霧 24H)、塑膠耐高溫		
客戶名稱			
供應廠商	全稱:東莞市碩方電子科技有限公司&DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD 簡稱:碩方/SOFNG		
產品認證	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS (無鉛)環保產品		<input type="checkbox"/> 其他_____

SOFNG Factory chapter

碩方發行	檢 查 TESTED BY	審 核 CHECKED BY	承 辦 APPROVAL
	Engineer Chen 陳		PMC Pan 潘
客戶承認	檢 查 TESTED BY	審 核 CHECKED BY	承 辦 APPROVAL

注意事項

- 1.水溶性助焊劑會使本產品腐蝕的可能,請避免使用;
- 2.給端子進行焊接時,如果在產品上施加壓力,會有移位、變形及電特性劣化可能,請在使用中注意;
- 3.焊兩次錫請在第一次焊接之後恢復到常溫再進行。連續加熱,會使塑膠變形&老化,端子鬆動&脫落及電特性降低的可能;
- 4.避免助焊劑滲入本產品, 會使產品損壞、接觸故障或動作不良;
- 5.印刷電路板&安裝孔位模式,請參照產品圖中記載的推薦尺寸;
- 6.在整機組合安裝工序中,請注意不要對產品施加外力;
- 7.在低電壓條件下 (DC1V 以下) 使用時,會有接觸不良的可能。以直流電阻的負荷設計本產品,不可用於其他負荷 (電感性負荷、電容性負荷);
- 8.在使用、測試過程中,如果超過規定以上的操作力,產品有損壞的可能;
- 9.請在常溫常濕[常溫 25°C,濕度在 50°C 以內]、不受陽光照射、不含腐蝕氣體的場所保存,自交貨起 6 個月內為限,請儘快使用。

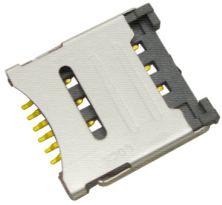
Operation: SMT & Hinge



LTEM NO.: SMO-1512 (Consumer Electronics)

(16.3L × 14.6W × 1.8H & MICRO-SIM Sockets)

MEMORY-CARD-SOCKETS



Technical parameter

外焊贴装 SMT

PROJECT	LEVEL	A[better product]		B[average product]	
		A[better product]		B[average product]	
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC			
	Initial Contact Resistance	50mΩ max.		80mΩ max.	
	Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC			
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute		350 V AC for 1 minut	
Durable Performance	There No Load	5,000 Cycles		3,500 Cycles	
	Rated Load	3,500 Cycles		2,500 Cycles	
	Storage temp.	-25℃~+85℃(Operating Temp:)			

側向導入 LATERAL

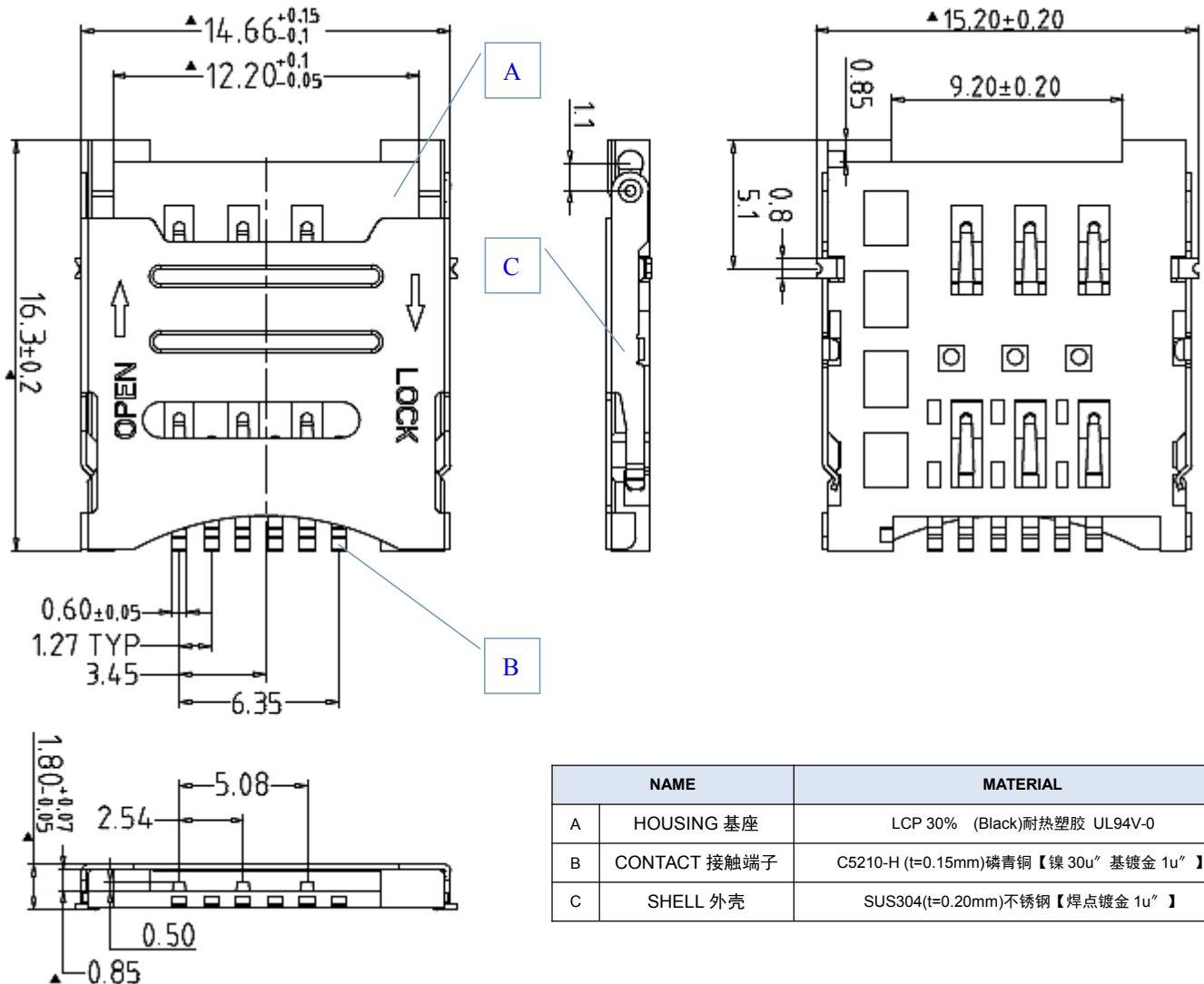
精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS

Page1

Unit:mm



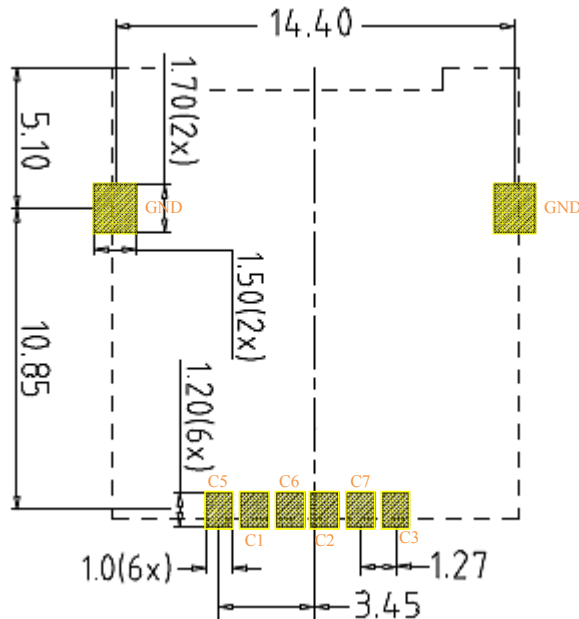
NAME	MATERIAL
A HOUSING 基座	LCP 30% (Black)耐热塑胶 UL94V-0
B CONTACT 接触端子	C5210-H (t=0.15mm)磷青铜【镍 30u" 基镀金 1u"】
C SHELL 外壳	SUS304(t=0.20mm)不锈钢【焊点镀金 1u"】

Operating Force

Inward 4.0~5.5N. (1N.=100gram-force)
 Exiting 4.0~5.5N. (1N.=100gram-force)

Solder-ability (Max.)

IR Reflow: 250°C, 5sec. Manual: 350°C, 3sec.

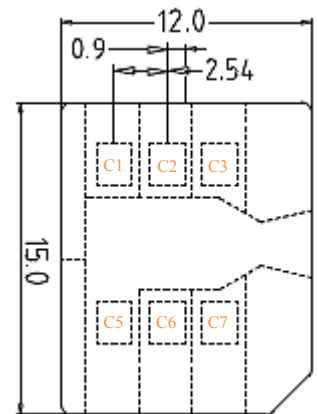


DECIMALS		ANGLES	
X	:±0.50	X°	:±3°
X.X	:±0.35	X.X°	:±1°
X.XX	:±0.25	X.XX°	:±0.5°

Pin definition

T-Flash CARD

Pin No.	Pin NAME	Type	Description
C ①	卡電源	1	VCC
C ②	復位	1	RST
C ③	時鐘	1	CLK
C ⑤	接地	1	GND
C ⑥	Vpp	1	VPP
C ⑦	輸入/輸出	1	I/O



MICRO-SIM



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。Products do not belong to hazardous waste, When waste can recycling processing

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25°C, 濕度在 50°C 以內], 不可導致材料變形或氧化。

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The SOFNG company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

SOFNG-PERFORMANCE REQUIREMENTS

Items	Requirements	Test Methods
1. Temperature rise 温度急变	30° C Max. 不高于30° C	Carry rated current load.0.3A per contact. (UL498) 每根端子负载0.3A 电流。(UL498)
2.Vibration Sinusoidal Low Frequency 低频正弦振动	No electrical discontinuity greater then 1 μ sec (s) shall occur. Contact resistance:100 mΩ max. 不允许出现超过1 μ sec (s) 的瞬间断开, 接触阻抗: 100 mΩ 最大;	Subject mated connector to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.5 mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular plane, 10 mA applied MIL-STD-202, Method 201. 对测试样品, 在频率变化每分钟从10-55-10 Hz, 振幅 1.5 mm 条件下, 在互相垂直的三个面上, 每个面2 小时下测量, 电流 10 mA ; 适用: MIL-STD-202 , 方法 201。
3.Shock 冲击	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. No damage to product. 不允许出现超过 1 μ sec (s) 的瞬间断开, 产品无损坏;	Applying an appropriate holder is allowed in vibration test and shock test. MIL-STD-202, Method 213,490m/s2, 3 axes. 使用合适的固定方式, 适用方法. MIL-STD -202, 方法213, 加速度490m/s2, 三个轴上均做测试。
4.Thermal shock 热冲击	No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max. 产品无损坏, 接触阻抗: 100 mΩ 最大	Temperature range from -55°C to +85°C .Start from -55°C. After 30 min. change to +85°C, change time is no more than 30 seconds. Total 5 cycles. MIL-STD-202, Method 107D,condition A. 温度变化范围: -55°C~ +85°C ; 从 -55°C 开始, 30 分钟后切换到 +85°C ; 转换时间不超过30 秒; 共5 个循环.适用: MIL-STD-202 , 方法107D , 条件A。
5. Humidity 恒温恒湿	No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max.. Dielectric Strength should be OK, Insulation Resistance should be 100 MΩ min. 产品无损坏, 接触阻抗: 100 mΩ 最大; 耐电压测试OK, 绝缘阻抗100MΩ 最小;	Temperature :40±2° C 96 hours. Relative humidity: 90-95%; Duration: 96 Hours. MIL-STD-202, Method 103, 温度: 40±2° C 96 小时; 相对湿度: 90-95% ; 时间: 96 小时; MIL-STD-202 , 方法 103。
6. Solderability 可焊性	Appearance of the specimen shall be inspected after the test with the assistance of a magnifier capable of giving a magnification of 10 X for any damage such as pinholes, void or rough surface. 样品在测试完成后, 用放大倍数为30 倍的显微镜, 检查外观损坏如: 小孔, 空焊, 外观粗糙度;	Soldering time: 3 to 5 Seconds Temperature: 255±5°C. 焊接时间: 3~5 秒, 温度: 255±5°C。
7. Resistance to soldering heat 耐焊接热	No damage 产品无损坏	Leave subject product in the 255±5°C chamber for 2 minutes. 产品置于255±5°C 烘箱内2 分钟。
8. Salt Spray 盐雾	Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max. 接触阻抗(未态) 100 mΩ max.	5±1% salt concentration 24±4 hours 35±2°C MIL-STD-202, Method 101 Condition B. 盐水浓度(重量比) 5±1%, 镀金区域时间24小时, 镀锡区域时间8小时。温度35±2°C; MIL-STD-202, 方法101 , 条件B。
9.High temperature 高温	Contact resistance: 100 mΩ max. 接触阻抗 100 mΩ max.	Subject product to 85±2°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108. 产品置于80 ±2°C 连续96 小时, 适用MIL-STD-202, 方法108。
10.Low temperature 低温	Contact resistance: 100 mΩ max. 接触阻抗 100 mΩ max.	Subject product to -25±5°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108. 产品置于-25 ±5°C 连续96 小时, 适用MIL-STD-202, 方法108。

PACKAGE SPECIFICATION 包装规范

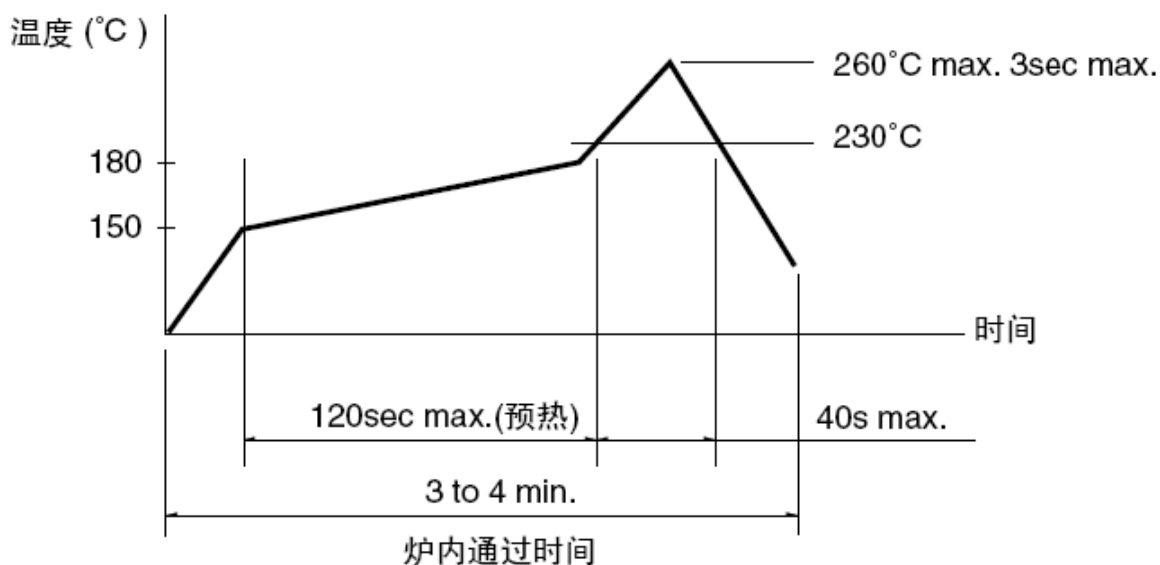
名稱	數量	備註
承载塑料带	1	後端 16cm 预留空料带 ▶ 最小包装数量标准 ▶ 前端 23CM 预留空料带.
热封胶带	1	F=可撕/拉开力量 25~130gf.
包装圆盘	1 sets	-
产品标签/认证标识	3	1. 单盘包装标识; 2. 检验合格标识; 3. 环保标识.
包装纸箱	依实际需要	若出货数量低于单品封箱数(通常为 5.0K) 空隙需进行填充.
厚纸板/抗震板	依实际需要	上、下各使用一片
防潮塑胶袋	3	1. 热封平口袋; 2. 防静电真空袋; 3. 热收缩袋。
干燥剂	2	使用于单品包装袋内.
纸制三角柱/抗压柱	4	使用于纸箱内四角.
封箱胶带	依实际需要	使用 SOFNG LOGO 胶带于纸箱开口工字型封合.
外箱标签	2	贴于纸箱相邻两面之右上角.

项目	条件
焊接温度	350°C max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

回流焊

[适用表面贴装型产品]

1. 加热方式：以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量：用 $\Phi 0.1\sim 0.2$ 的CA (K) 或CC (T) 测量位置在焊接连接部 (锡/铜箔面)。
3. 固定方式：采用耐热胶带。
4. 温度分布：(图 2.15)

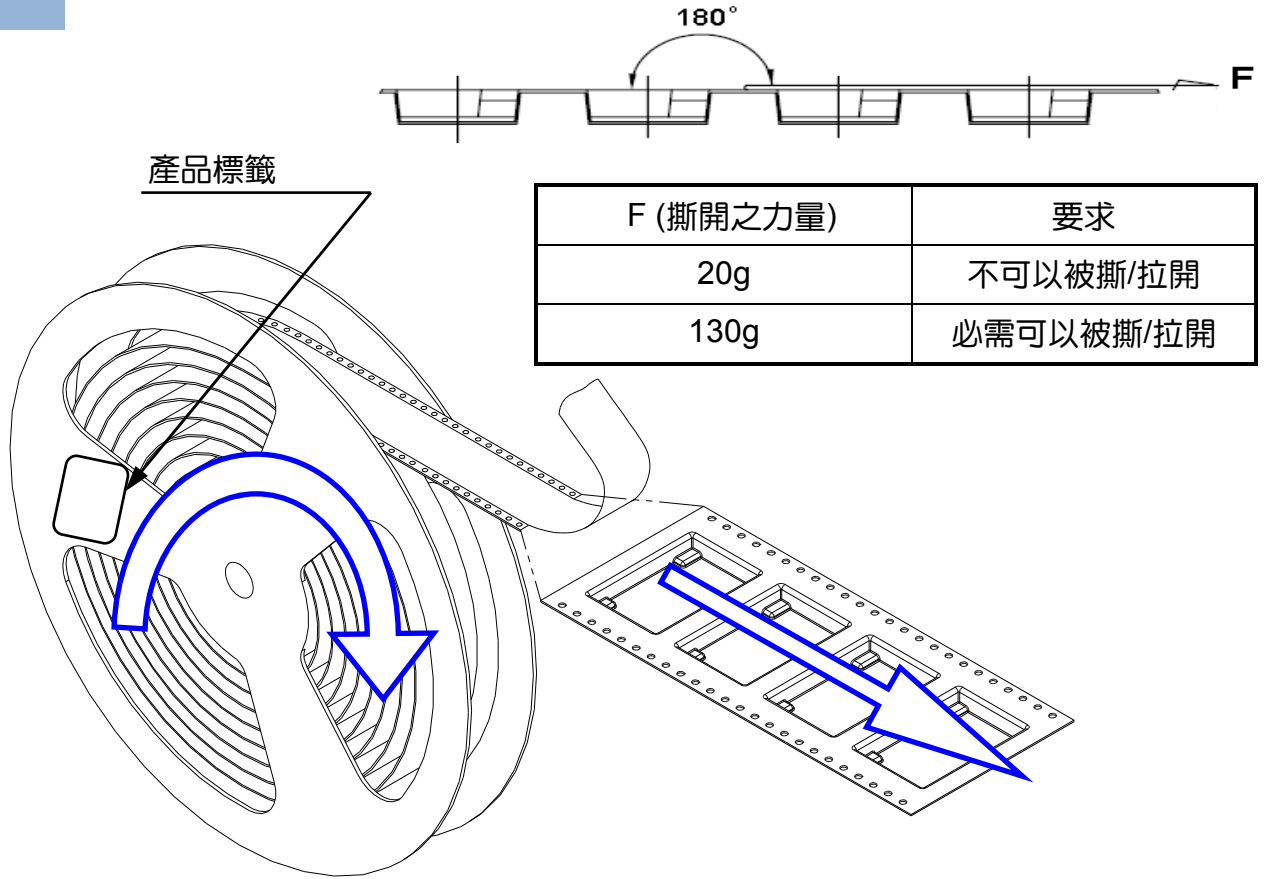


2.15

浸焊式

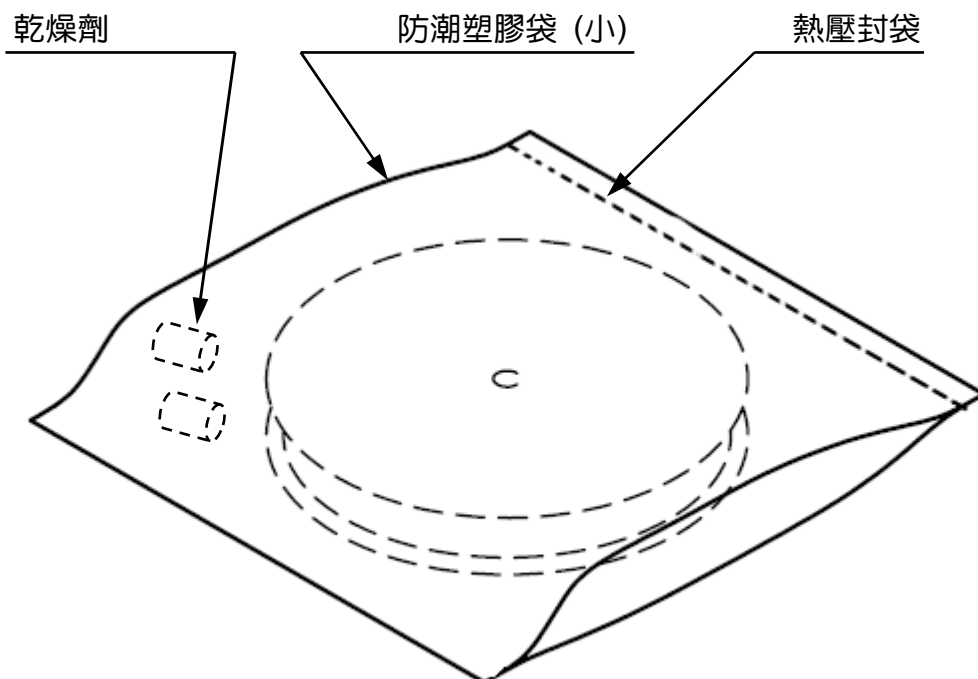
项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2次以下

1. 载带缠绕方向



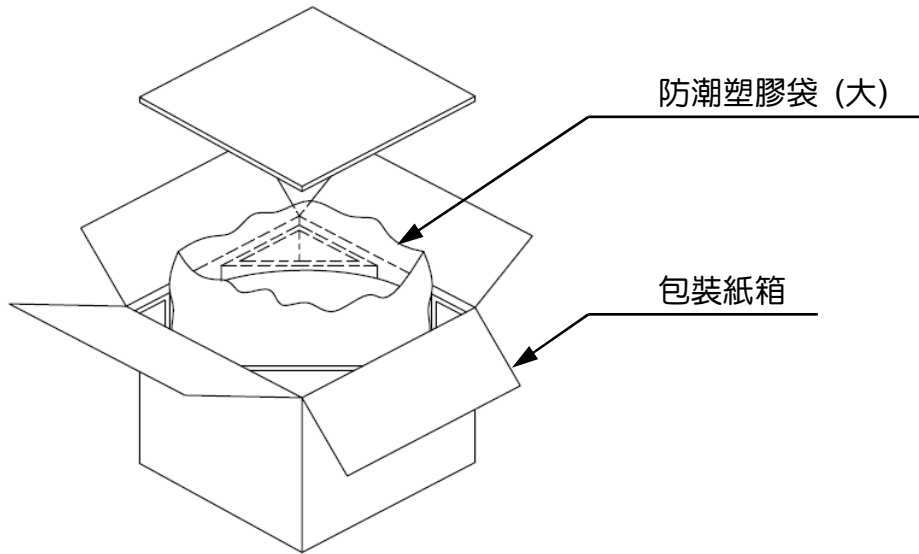
依上述之各項，將產品包入承載料帶內，並封上熱封膠帶，貼上產品標籤。

將完成之料盤放入防潮塑膠袋內，置入兩包乾燥劑，確認無誤後，將塑膠袋口整理平順後，使用熱壓封口機將塑膠袋封口，如下圖所示。



2. 单品包装示意图

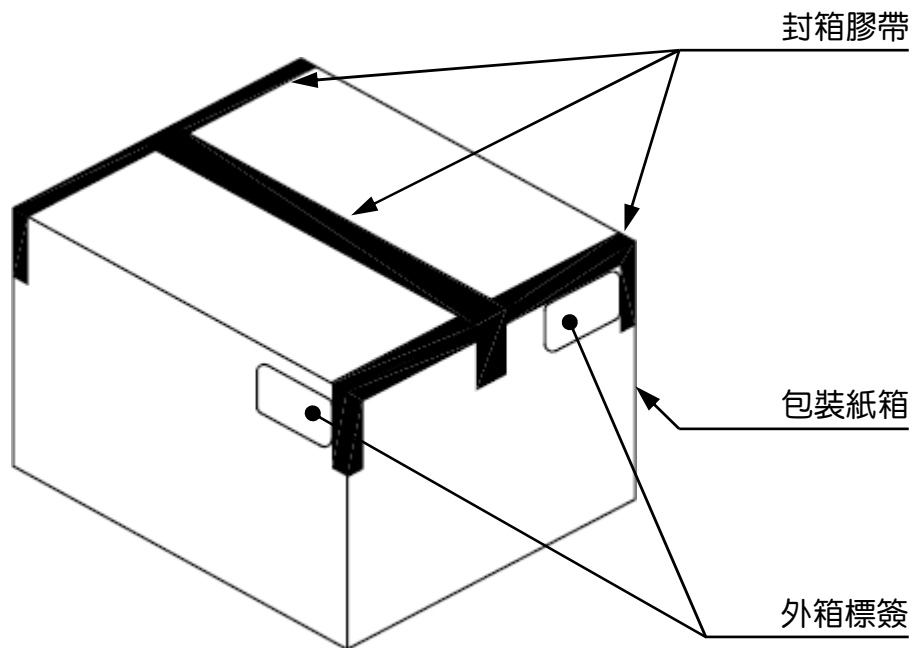
3. 内容及填充示意图



確認置入之捲料盤數量無誤後，將塑膠袋整理平順，加以折疊並塞入紙箱之中，最後再將紙箱封好。如上圖所示。

以封箱膠帶依下圖之位置封好。

貼上出貨標籤。完成之出貨包裝如下圖。



硕方封箱胶带图



4. 外封箱示意图